

金属メッキ工程における PFOS を含有する表面処理剤の推定使用量は 2～3t/年である⁸⁾。フォトマスク(半導体及び液晶ディスプレイ)製造工程における PFOS 及びその類縁化合物(PFOS 骨格を持つ物質、以下同様)の推定使用量は約 0.07t/年である⁹⁾。写真工業における平成 16 年の使用量は 3.6t/年である⁸⁾。PFOS を含む泡消火剤の備蓄量は、約 21,000t(PFOS 換算量:200t 未満)である⁹⁾。

② 用途

PFOS 及びその類縁化合物の主な用途は、半導体工業、金属メッキ、フォトマスク(半導体、液晶ディスプレイ)、写真工業、泡消火剤である⁸⁾。また、代替が困難な用途としては、半導体(反射防止膜及びフォトレジスト)、フォトマスク(半導体及び液晶ディスプレイ)、写真感光剤、メッキ(クロムメッキ等)、泡消火剤、医療機器(カテーテル及び留置針)、電気電子部品(プリンター・複写機用転写ベルト・ゴムローラー等)である¹⁰⁾。

PFOS の類縁化合物が微生物分解やより大型の生物による代謝を受け、PFOS が生成される可能性が指摘されている¹⁾。

(5) 環境施策上の位置付け

ペルフルオロオクタンスルホン酸及びそのカリウム塩、リチウム塩は化学物質審査規制法第二種監視化学物質(通し番号:681(酸)、685(カリウム塩)、683(リチウム塩))に指定されている。